

证券代码：002156

证券简称：通富微电

通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东方证券：张婧婧；农银汇理：张璋；平安资管：马继愈；天弘基金：蔡锐帆；上海刚泉资产：季德全；财通资管：洪骐、李晶；天风资管：殷成钢；寻常投资：杜凡；朱雀基金：黄昊；国信证券：何嘉；Power Pacific：林昊。
时间	2023年7月20日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 蒋澍
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司概况</p> <p>通富微电主要从事集成电路封装测试业务，公司大股东为南通华达微电子集团股份有限公司，实际控制人为石明达先生，股权结构稳定。</p> <p>公司抓住行业发展机遇，坚持发展主业的指导方针，注重质量，加快发展，继续做大做强。公司先后在江苏南通崇川、南通苏通科技产业园、安徽合肥、福建厦门建厂布局；通过收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85%股权，在江苏苏州、马来西亚槟城拥有生产基地；2021 年，公司新增第七个封测基地——通富通科，位于南通市北高新区；2022 年上半年，通富通科一期约 2 万平米的改造厂房投入使用，二期约 3.4 万平米的厂房机电安装改造完成并顺利投产，创造了新的“通富速度”，为配合国家实现自主</p>

可控的存储器产品生产，做好厂房建设准备；2022年6月14日，通富超威槟城启动新厂房建设仪式，新厂房占地约85亩，预计2023年竣工投入使用。目前，公司在南通拥有3个生产基地，同时，在苏州、槟城、合肥、厦门也积极进行了生产布局，产能方面已形成多点开花的局面。先进封装产能的大幅提升，为公司带来更为明显的规模优势。

财务数据方面，公司2018年、2019年、2020年、2021年和2022年分别实现营收72.23亿元、82.67亿元、107.69亿元、158.12亿元和214.29亿元。公司2018年、2019年、2020年、2021年和2022年的归母净利润分别为1.27亿元、0.19亿元、3.38亿元、9.57亿元和5.02亿元。

## 二、行业情况

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。近年来，国家相继出台了若干产业政策，大力支持集成电路产业发展。

2022年，受欧洲地缘政治风险升级、美国持续高通胀等外部因素影响，全球经济面临巨大挑战，全球经济前景的不确定性导致行业需求下降，集成电路下游终端应用市场出现了较为明显的结构性失衡：从下游应用端看，汽车电子市场发展迅猛，但汽车应用在集成电路市场中占比还不高；与此同时，计算机与通信仍是主要拉动力，而计算机市场处于饱和乃至部分萎缩状态，以智能手机为代表的通信市场进入调整期，库存高企。上述情况导致集成电路行业景气度下降，2022年第二季度开始集成电路销售额增速逐季下滑。随着全球经济回暖，AI、数据中心、5G、智能汽车等新兴应用端需求持续发展，2023年集成电路产业有望触底并逐渐复苏。短期来看，公司2023年生产经营“挑战与机遇”并存，挑战是公司可能会面临行业触

底过程中的阵痛，机遇是行业新技术（Chiplet 等先进封装新技术）、新应用（ChatGPT 等人工智能新应用）带来的广阔发展空间。

### 三、公司发展优势

半导体行业具有导入周期长且准入门槛高的特点，在通过客户验证形成合作后，业务稳定性较强且客户粘性较大，通富微电经过多年积累拥有优质的全球客户资源。目前，大多数世界前 20 强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为通富微电的客户。

公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。公司面向未来高附加值产品及市场热点方向，在高性能计算、存储器、汽车电子、显示驱动、5G 等应用领域，大力开发扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能，此外积极布局 Chiplet、2.5D/3D 等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。

2022 年，公司积极调整产品业务结构，加大市场调研与开拓力度，持续服务好大客户，凭借 7nm、5nm、FCBGA、Chiplet 等先进技术优势，不断强化与 AMD 等行业领先企业的深度合作，巩固和扩大先进产品市占率。2022 年，公司实现营业收入 214.29 亿元，同比增长 35.52%。在全球前十大封测企业中，公司营收增速连续 3 年保持第一；2022 年，公司在全球前十大封测企业中市占率增幅第一，营收规模排名进阶，首次进入全球四强（数据来源：芯思想研究院）。

2022 年，公司技术研发水平再创新高，构建国内最完善的 Chiplet 封装解决方案，发展国内领先的大功率模块技术，积极推动先进移动终端芯片国产化方案。2022 年，公司申请专利 165 件，先进封装技术类专利申请占比

超 60%，为公司产业升级做好铺垫；专利授权量同比增长近 40%，公司喜获江苏省专利项目“优秀奖”。

通过并购，公司与 AMD 形成了“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系；AMD 完成对全球 FPGA 龙头赛灵思的收购，实现了 CPU+GPU+FPGA 的全方位布局，双方在客户资源、IP 和技术组合上具有高度互补性，有利于 AMD 在 5G、数据中心和汽车市场上进一步迈进。公司是 AMD 最大的封装测试供应商，占其订单总数的 80%以上，未来随着大客户资源整合渐入佳境，产生的协同效应将带动整个产业链持续受益。

2022 年，公司实现营业收入 214.29 亿元，同比增长 35.52%，其中，通富超威苏州、通富超威槟城凭借 7nm、5nm、FCBGA、Chiplet 等先进技术优势，不断强化与 AMD 等行业领先企业的深度合作，巩固和扩大先进产品市占率，实现销售业绩稳步增长。2022 年，通富超威苏州及通富超威槟城合计实现营收 143.85 亿元，同比增长 74%，合计实现净利润 6.67 亿元。通富超威苏州及通富超威槟城合计营收、合计净利润连续 6 年实现增长。

#### **四、2023 年半年度业绩预计**

2023 年上半年，受外部经济环境及行业周期波动影响，全球半导体市场疲软，下游需求复苏不及预期，导致封测环节业务承压，公司传统业务亦受到较大影响，归母净利润预计出现亏损。公司立足市场最新技术前沿，努力克服消费类电子市场不振及产品价格下降带来的不利影响，积极调整产品布局，在高性能计算、新能源、汽车电子、存储、显示驱动等领域实现营收增长，积极推动 Chiplet 市场化应用，实现了规模性量产。经公司财务部门初步统计，2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 99.09 亿元左右，同比增长 3.58%左右。

基于国内外大客户高端处理器和 AI 芯片封测需求的不断增长、先进封测技术的更新迭代等因素，通富超威槟

	<p>城持续增加美元贷款,用于新建厂房,购买设备和原材料,特别是为未来扩大生产增加备料较多。上述情况,使得公司合并报表层面外币净敞口主要为美元负债,由于美元兑人民币汇率在2023年第二季度升值超过5%致使公司产生较大汇兑损失,经公司财务部门初步统计,因汇兑损失减少归属于母公司股东的净利润2.03亿元左右,如剔除上述汇率波动影响,2023年上半年公司归属于母公司股东的净利润为正。2023年半年度详细情况,可以关注公司后续披露的《2023年半年度报告》。</p>
附件清单(如有)	—
日期	2023年7月20日